

● 基于 Kintex UltraScale 系列 FPGA 高性能 PCIe 数据预处理载板(5GByte/s 带宽)

Product ID: PCIE702



Power Module Power Module ATX Power In Module ATX Power In Module ATX Power In Module Physics ATX Power In Module ATX Power In

技术指标

- 板载 FPGA 实时处理器: XCKU060-2FFVA1517;
- 与 XCKU085-2FFVA1517I 以及 XCKU115-2FFVA1517I 可以实现 PIN-PIN 兼容,可升级 FPGA 资源容量;
- PCIE 主机接口:
 - ➤ X8 PCIe 互联;
 - > 支持 PCIe gen3 x8@8Gbps/lane;
 - ➤ 独立的 XDMA 控制器,带宽高达 5GByte/s;
 - ▶ 支持 Win10/Win server 操作系统;
- FMC 接口指标:
 - ▶ 标准 FMC+ (HPC)接口,符合 VITA57.4 规范;
 - ▶ 支持 x16 GTH@16Gbps/lane 高速串行总线;
 - ▶ 支持 80 对 LVDS 信号;
 - ▶ 支持 IIC 总线接口;
 - > +12V/+VADJ供电,供电功率≥15W;
 - ➤ 独立的 VIO_B_M2C 供电 (可由子卡提供);
- 动态存储性能:
 - ▶ 缓存数量:2组独立的DDR4SDRAM;
 - ▶ 存储带宽: 72 位, 1200MHz 工作时钟, 2.4GHz 数据率;
 - ▶ 存储容量:每组最大支持4GByte DDR4SDRAM(默认2GB);
- 其它接口性能:
 - ▶ 24 路 LVTTL GPIO 接口,1路 RS422 接口;
 - ▶ 1路 RJ45 干兆以太网接口;
 - ▶ 2路 QSFP+ 40G 万兆光纤接口;
 - ➤ 板载 2 个 SPI Flash 用于 FPGA 的加载;
- 物理与电气特征
 - ▶ 板卡尺寸: 106 x 207mm;
 - ▶ 板卡供电: 5A max@+12V (±5%, 不含给子卡供电);
 - ▶ 散热方式:风冷散热;
 - ▶ 工作温度: -20°~80°C;

板卡概述

PCIE702 是一款基于 PCIE 总线架构的高性能数据预处理 FMC 载板,板卡具有 1 个 FMC+(HPC)接口,1 路 PCIe x8 主机接口、1 个 RJ45 干兆以太网口、2 个 QSFP+ 40G 光纤接口。板卡采用 Xilinx的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA 作为实时处理器,实现 FMC接口数据的采集、处理、以及背板接口互联。板载 2 组独立的 72 位DDR4 SDRAM 大容量缓存。该板卡通过搭载不同的 FMC 子卡,可快速搭建起基于服务器的数据采集、实时处理、高性能存储平台。可广泛应用于雷达与中频信号采集、视频图像采集等场景。

软件支持

- 可选集成板级软件开发包(BSP):
 - ➤ FPGA 底层接口驱动;
 - PCIe 总线接口开发及其驱动程序;
- 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:

应用范围

- 雷达与中频信号处理;
- 软件无线电验证平台;
- 图形与图像处理验证平台;

订购信息

产品型号	产品描述
PCIE702	基于 PCIE 总线架构的高性能数据预处理载板



Tel: 15811214467 Fax: 010-62969321 www.tsingetech.com